

最先端科学技術を支えるドライプロセスの基礎と応用

学生・地域企業技術者対象 国際OPEN TECHシンポジウム

— 活きた英語と日本語で —

ドライプロセスをはじめとして、グリーンイノベーションやプラズマエレクトロニクス分野、スマートフォンなど身近な製品の製造、AI、ビッグデータ、宇宙開発など、さまざまな最先端の研究開発は真空技術により支えられています。

このセミナーでは、真空技術の原理とそのシステムや、真空技術を用いたプロセスとデバイスの最前線について、第一線で活躍する研究開発者が活きた英語と日本語で教えます。



開催日時 2018年7月21日（土）13:30 - 18:00（13:00開場）

場 所 京都工芸繊維大学 松ヶ崎キャンパス
15号館 N105室



京都市左京区松ヶ崎橋上町1（京都地下鉄丸線「松ヶ崎」駅下車徒歩約8分）

企画・運営：京都工芸繊維大学・電子システム工学課程・プラズマ基礎工学研究分野
共催：ライボルト株式会社
協力：日新電機株式会社、東京エレクトロン株式会社、サンディスク株式会社

参加無料

どなたでも聴講できます。裏面のフォームでお申し込みください。

京都工芸繊維大学主催 シンポジウム

最先端科学技術を支えるドライプロセスの基礎と応用

— 活きた英語と日本語で —

【講演者プロフィール】

Peter Lambertz

Leybold GmbH (ドイツ)
Business Development Manager R&D Market
RWTH Aachen University 修士課程修了 工学修士
Hagen University 産業工学課程修了 経営工学修士

松尾 大輔

日新電機株式会社 研究開発本部 ビーム・プラズマ技術開発研究所
岡山理科大学 大学院工学研究科 博士課程修了 工学博士

廣田 良浩

東京エレクトロン株式会社
コーポレート技術マーケティング部 デバイス技術プロジェクト プリンシパルエンジニア
京都工芸繊維大学 大学院工芸学研究科 修士課程修了 工学修士

吉元 諒

サンディスク株式会社 Advanced Process & Device Development Group プロセスエンジニア
大阪大学 大学院理学研究科 化学専攻 博士課程修了 理学博士

【プログラム】

第1部：真空技術について (Leybold GmbH)

英語でインタラクティブに進めます

真空の原理と真空システム
世界の最先端の研究開発に活用される真空技術

第2部：真空技術が不可欠なデバイスやプロセスの最前線 日本語で解説します

- IGZOパネル向け製造装置の開発 (日新電機株式会社)
- Semiconductor Memory Process-Device Technology utilizing Manufacturing Equipment Supported by Vacuum Science and Technology (東京エレクトロン株式会社)
- Dry etch challenges for vertical scaling of 3D memory (サンディスク株式会社)

お申し込み方法

いずれかの方法でお申し込みください。

① 入力フォームでのお申し込み

京都工芸繊維大学専用ウェブサイト <https://www.kit.ac.jp/form/view/index.php?id=58325>

② FAXまたはメールでのお申し込み (切り取らずにこのままお送りください)

E-mail : sangaku@jim.kit.ac.jp FAX : 075-724-7750

定員になり次第、受付を終了させていただきます。

フリガナ	
お名前	
職名・学年等 (企業の方は会社名、所属)	
ご住所	〒
TEL	() -
E-mail	

【お問い合わせ先】

ご提供いただいた情報は、本講演会の運営に関する目的のみで使用します。

京都工芸繊維大学 産学・地域連携課

〒606-8585 京都市左京区松ヶ崎橋上町1

TEL : 075-724-7035

駐車場はございませんので公共交通機関を利用してお越しください。